

Product Change Notice (PCN)

件名: MOSFET TO-252 パッケージ製品の組立/選別拠点追加のご案内

発行日: 12/12/2024

出荷開始予定日: 7/1/2025

改版履歴:

初版

変更内容の説明:

対象 PKG : TO-252

組立、選別拠点

追加拠点: ATX Semiconductor Co., Ltd. (ATX-WH)

既存拠点: Renesas Semiconductor (Malaysia) Co., Ltd. (RSM)

項目	追加	既存
組立工程拠点	ATX-WH	RSM
選別工程拠点	ATX-WH	RSM
パッケージ外形	相違あり(*1を参照して下さい)	
リードフレーム	Cu系 LF	Cu系 LF
ダイボンド材	PbSn はんだ	PbSn はんだ
ボンディングワイヤ	Al ワイヤ	Al ワイヤ
モールド樹脂	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)	エポキシ樹脂 (ハロゲン含有)
リード表面仕上(めっき)	Sn 100%	Sn-Bi
梱包材	エンボステープ	エンボステープ

対象製品リスト:

H7P0601DSTL-E			
H7N0603DSTR-E			

変更の理由:

対象製品の安定供給を目的としております。

外形、実装、機能、品質、信頼性への影響:

外形: *1を参照して下さい。

実装、機能、品質、信頼性: 影響ありません。

製品の識別方法:

製品のトレースコードにて識別可能です。弊社営業にお問い合わせください。

信頼性データについて: 信頼性試験は完了しております。結果は提出可能です。

サンプル出荷予定日: 1/10/2025

ご要求に応じて提出可能です。

製品/材料の化学物質データ: ご要求に応じて提出可能です。

*1 ; パッケージ外形図、寸法比較 参照

	概略図	寸法値 [単位 : mm]	
現状			
追加			
		既存	追加
		A	2.30
		A1	0~0.25
		b	0.80
		b3	5.60
		c	0.55
		c2	0.55
		D	5.50
		D1	4.5min
		E	6.50
		E1	4.7min
		e	2.29
		H	9.5
		L	0.5min
		L3	1.5

ご注意:

1. PCN をお客様にお渡しした後 30 日以内に受理の御連絡を頂けない場合は、変更内容を御承認頂いたものとみなして変更を実施させていただきます。
2. お客様が PCN を受理されて承認手続きのための条件が有る場合は、PCN をお客様にお渡しした後 90 日以内に御連絡をお願い致します。90 日以内に何の御連絡もない場合も御承認頂いたものとみなして変更を実施させていただきます。
3. 変更内容について御承認頂けない場合、最終注文数の御提示と御発注をお願い致します。

この通知に関するお問い合わせは、弊社営業、特約店までお願い致します。